

～価格競争力に自信あり～

ガラスハーメチック(気密端子・コネクタ)への 高精度な金めっき 量産技術



<PR>

①低コストの量産処理が可能です

電解めっきのベースとリードピンの膜厚差が小さい(膜厚比 約1:1.5)
量産バッチでも固体ごとの膜厚ばらつき幅を小さくできます
形状・ピン径に合わせ、通電用ダミーを最小数で済むようカスタムします

②ワイヤーボンディングのための、専用金めっき被膜

長年の実績から、専用のめっき液組成で対応

③変形・絡まりやすい、多ピンでリードが長いピンもOK

様々なめっき治具を用意しており、製品へのストレスが
少ないめっきができます

④扱いが難しい小型品(ステム径φ2・ピン径φ0.25)も対応OK

⑤セラミックベースの、ピンのみめっきOK

<用途>

ステム(光素子用、各種センサ・トランジスタ・IC 等)
コネクタ(高電圧・高電流・耐水・耐圧用 等)



<めっき仕様>

ニッケルめっき 下地or仕上げ

電解 ニッケルめっき(Ni) : 光沢・無光沢
無電解 ニッケルめっき(Ni-p)

金めっき 仕上げ:軟質めっき

(ワイヤーボンディング専用めっき)

電解 金めっき(Au) : 無光沢
無電解 金めっき(Au) : 無光沢

～不可能への挑戦～

株式会社 友電舎
大阪市此花区常吉2丁目4番8号
TEL:06-6465-1663
Mail:joho1@ydn.co.jp
URL:http://www.ydn.co.jp

